

(18)日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-126002

(43)公開日 平成10年(1998)5月15日

(51) Int.Cl.
H01S 3/18
G02B 6/42

138 電子學

FI
H01S 3/18
G02B 6/42

1

01S 3/18
02B 6/42

四

H01S 3/18
GD2B 6/42

(2) 出圖卷目 總圖五三-200429

(22)出願日 平成8年(1996)10月23日

(21) 展開 : 00000058 M

船下雙子丁蓋特威金社

松下電子工業株式会社
大阪府東大阪市春日1番1号

(7) 高階者 主持 管理

水井 力
大阪府高槻市空町1番1

大阪府高槻市幸町1番1号 松下電子工業
株式会社内

(72) 発明者 中西 素行

大阪府高槻市幸町1番1号 松下電子工業
株式会社内

(72)発明者 油利 正昭

大阪府高槻市幸町1番1号 松下電子工業
株式会社内

(74) 代理人 弁理士 滝本 智之 (外1名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名稱】 光伝送モジュール

(57)【要約】

【課題】 LANなどのデータ伝送に用いる光伝送モジュールが、半導体レーザ光の出射方向と受光素子の受光方向とが実装面に対して 90° 異なるため、組み立てが複雑になり、かつ小型化するのが困難であった。

【解決手段】半導体レーザ18の台座25となるS1基板に(111)面を利用した反射ミラー20を形成して半導体レーザ光19を台座の実装面に対して垂直に出射させることにより、半導体レーザ18、駆動回路26、受光素子24、電流-電圧変換回路28等を同一パッケージ30に平面実装し、光ファイバー16、17が接続されたレンズ部で封止する。

